

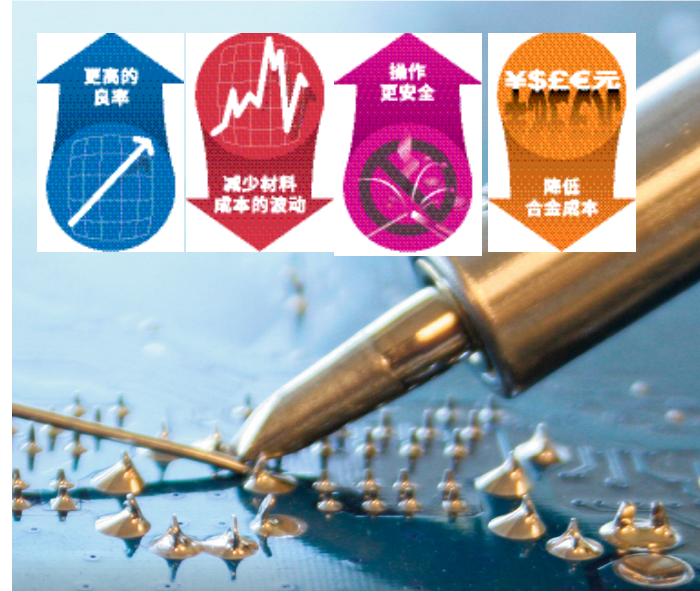
ALPHA[®] HF-850

无卤素、无卤化物、免清洗、有芯焊丝

快速润湿、低飞溅 有芯焊丝

ALPHA Telecore HF-850 是一款润湿速度最快、飞溅水平最低的无卤素/无卤化物的有芯焊丝。与市场上的含卤素和卤化物的竞争产品相比，它具有出色的性能并且更环保。

ALPHA Telecore HF-850的迅速润湿能力满足拖焊要求并且将机械以及手动焊接应用的周期缩至最短。其透明的焊接残留使得焊点检查非常容易；极低的飞溅水平确保板片外观和用户舒适性。这种安全环保的产品使操作人员使用更方便，同时保持高生产率。



主要特性优点

- ALPHA HF850与我们的Innolot合金结合使用可提供最高的热机械可靠性
- 符合IPC J-STD-004的无卤标准并符合IPC ROL0标准
- 非常快速的润湿能力 – 对元件进行手工焊接和装配的理想选择
- 无卤素配方 – 适用于要求无卤素的工艺
- 非常低的助焊剂飞溅及烟雾水平 – 操作人员使用更方便，并且保持工作环境清洁
- 透明的非粘性残留物 – 不需要清洗
- 良好的扩散性能 – 提高产品的首次良率 (根据 JIS 标准, > 80%)
- 优异的焊点外观 – 便于检查



* 完全不含卤素的定义为无特意添卤素。

ALPHA® HF-850

无卤素、无卤化物、免清洗、有芯焊丝

ALPHA Telecore HF-850 是一款润湿速度最快、飞溅水平最低的无卤素/无卤化物的有芯焊丝。与其他无卤素/无卤化物产品相比，能满足绝大多数环保要求。

技术规格

标准	合金* 描述	熔点或固/液相点温度 °C	助焊剂比例
专有的	InnoLot**	206–218	2.2%
J-STD-006C	SAC305	217–221	1.1%, 2.2%, 3.3% & 4.4%
Proprietary	SACX Plus® 0307	217–228	2.2% & 3.3%
J-STD-006C	Sn99.3/Cu0.7	227	2.2% & 3.3%
J-STD-006C	Sn63/Pb37	183	1.1%, 2.2% & 3.3%
专有	SnCX™ Plus 07	227–229	2.2% & 3.3%

* 也可根据客户需求提供其他或特殊合金配方。
** 所有使用 InnoLot 焊接合金的电子产品必须是无铅以免 形成熔点低于100°C的锡/铅/铋金属间化合物。
*** 在机械焊接应用中，4.4% 助焊剂含量有助于达成 IPC-610 第三级标准（100% 通孔填充）的目标。

ALPHA Telecore HF-850 是一款无卤素产品，并且符合下列标准：

卤素标准

标准	规格	测试方法	结果
IEC 612249-2-21	焊后残留物中从阻焊剂析出的氯或溴含量 低于900ppm或总量低于1500 ppm	TM EN 14582	合格
JEDEC: “低卤素” 电子产品定义指南	焊后残留物中从阻焊剂析出的氯或溴含量低于1000ppm		合格
物理属性		典型值	
松香软化点:		70-80°C	
酸值:		180-200mg KOH/每克助焊剂	
卤化物含量:		<500ppm 根据 IPC J-STD-004	
物质分类:		IPC – ROL0	
保存寿命/存储温度:		36 个月 / 0°– 40°	
电气可靠性测试		要求	结果
湿热测试(IEC 60068-2-78)		不小于 $1.0 \times 10^8 \Omega$ ***	合格
JIS 表面绝缘阻力测试 (JIS Z 3197)		不小于 $1.0 \times 10^{11} \Omega$	合格
IPC 表面绝缘阻力测试 (J-STD-004A)		不小于 $1.0 \times 10^8 \Omega$	合格
IPC 表面绝缘阻力测试 (J-STD-004B)		不小于 $1.0 \times 10^8 \Omega$	合格
Bellcore 表面绝缘阻力测试 (GR-78-CORE)		不小于 $1.0 \times 10^{11} \Omega$	合格
Bellcore 电子迁移测试 (GR-78-CORE)		表面绝缘阻力(初值)/表面绝缘阻力(终值) <10	合格

***IEC 60068-2-78 没有指定最小电阻值。Alpha已采用所述值。

化学可靠性测试	要求	结果
铜镜测试 (JIS)	无整体铜脱落	合格
铜镜测试 (IPC-TM 650 TM 2.3.32)	无整体铜脱落	合格
铜腐蚀性测试 (JIS)	无腐蚀发生	合格
铜腐蚀性测试 (IPC-TM 650 TM 2.6.15)	无腐蚀发生	合格

